

半导体器件测试实验，稳压二极管的检测

产品名称	半导体器件测试实验，稳压二极管的检测
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

产品详情

半导体器件测试实验，稳压二极管的检测

半导体测试 有CP测试和 Final test,现在就大致的来说一下两者的区别

苏州七剑软件-----行业的半导体智能化解决方案专家

CP是把坏的Die挑出来，可以减少封装和测试的成本。可以更直接地知道Wafer的良率。

FT是把坏的chip挑出来；检验封装的良率。8 %

现在对于一般的wafer工艺，很多公司多吧CP给省了；减少成本。

CP 对整片Wafer的每个die来测试

而FT 则对封装好的Chip来测试。

C P Pass才会去封装。然后 F T ，确保封装后也PASS。

WAT是Wafer Acceptance Test，对专门的测试图形（test key）的测试，通过电参数来监控各步工艺是否正常和稳定；

CP是wafer level的chip probing，是整个wafer工艺，包括backgrinding和backmetal（if needed），对一些基本器件参数的测试，如vt,Rdson,BVdss,Igss,Idss等，一般测试机台的电压和功率不会很高；

FT是packaged chip level的Final Test，主要是对于这个（CP passed）IC或Device芯片应用方面的测试，有些甚至是待机测试；

Pass FT还不够，还需要做process qual和product qual

CP测试对Memory来说还有一个非常重要的作用，那就是通过MRA计算出chip level的Repair address，通过Laser Repair将CP测试中的Repairable die修补回来，这样保证了yield和reliability两方面的提升。

CP是对wafer进行测试,检查fab厂制造的工艺水平

FT是对package进行测试,检查封装厂制造的工艺水平

对于测试项来说,有些测试项在CP时会进行测试,在FT时就不用再次进行测试了,节省了FT测试时间;但是有些测试项必须在FT时才进行测试(不同的设计公司会有不同的要求)

一般来说，CP测试的项目比较多，比较全；FT测的项目比较少，但都是关键项目，条件严格。但也有很多公司只做FT不做CP(如果FT和封装yield高的话，CP就失去意义了)。
